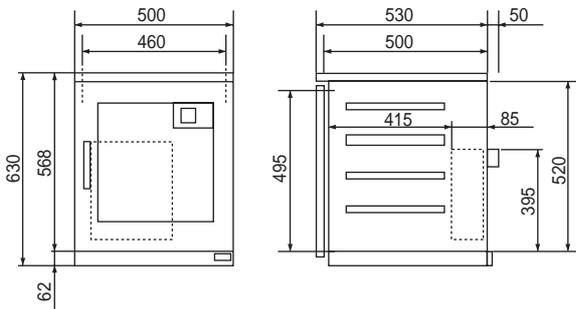


マックドライ (超低湿3%タイプ)

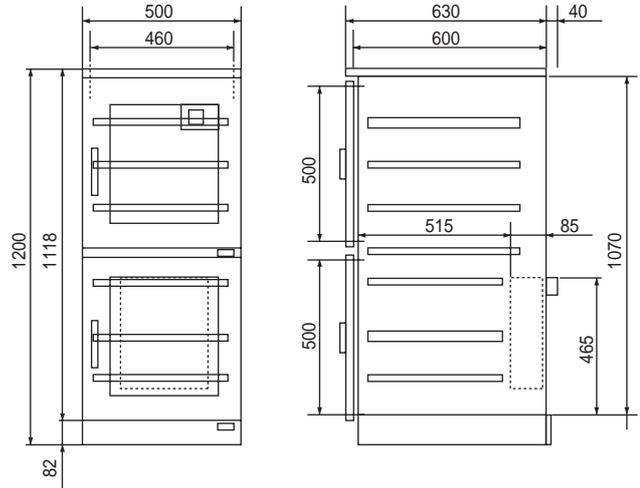
外形寸法図

(単位: mm)

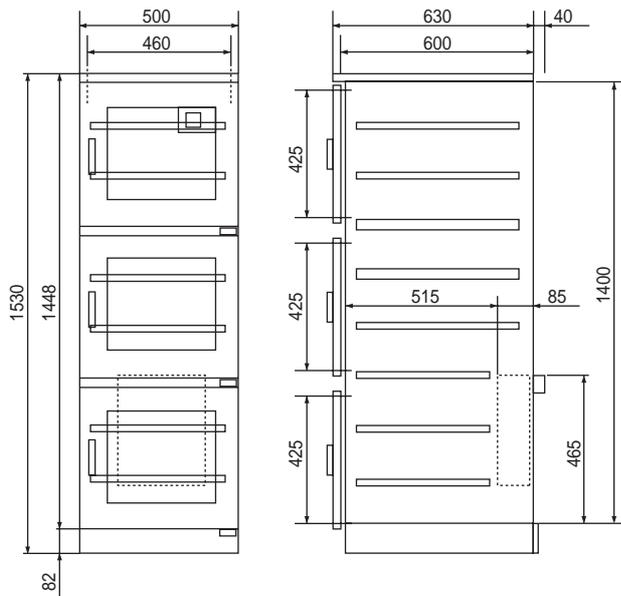
6-8411-01



6-6457-01



6-6542-01



脱湿原理

6-8411-01, 6-6457-01, 6-6542-02

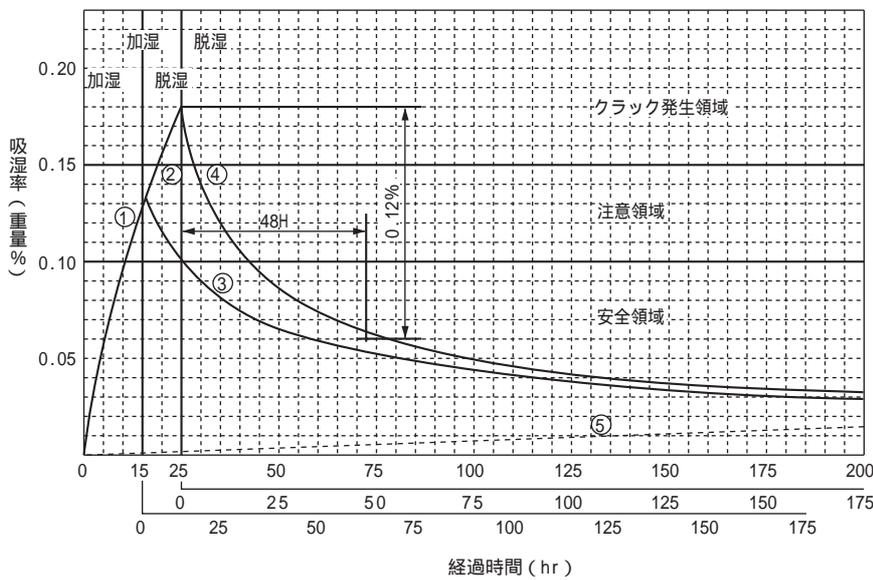
強力な吸着剤によりケース内を常温超低湿に保ちます。

このケース内にICパッケージ及びプリント配線板等の電子部品を保管することにより品物から水分を脱湿します。

吸着剤が飽和すると自動的に加熱再生を行ないます。この時のダンパーの切り替えアクチュエーターとして、形状記憶合金コイルを使用しています。

ICパッケージの吸湿・脱湿データ

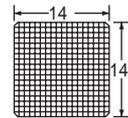
6-8411-01, 6-6457-01, 6-6542-02



TQFP

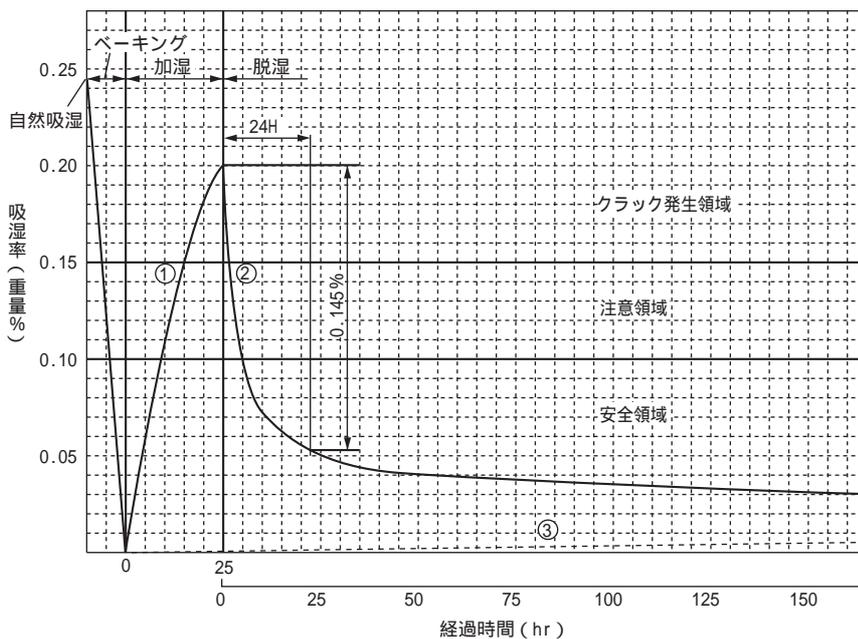
試料：フラットパッケージ型IC (TQFP)
前処理：+125 で24時間ベーキング処理を行う。

厚さ1.4mm



測定条件

- ① 周囲環境 (+30、85%RH) に15時間放置。(恒温恒湿室を使用)
- ② 周囲環境 (+30、85%RH) に25時間放置。(恒温恒湿室を使用)
- ③ 上記①の処理後低湿保管ケースに175時間保管 (8%RH)
- ④ 上記②の処理後低湿保管ケースに175時間保管 (8%RH)
- ⑤ ベーキング処理後低湿保管ケースに保管 (8%RH)

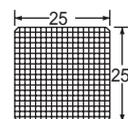


PBGA

試料：PBGA

前処理：+125 で24時間ベーキング処理を行う。

厚さ1.8mm



測定条件

- ① 周囲環境 (+30、85%RH) に25時間放置。(恒温恒湿室を使用)
- ② 上記①の処理後低湿保管ケースに150時間保管 (5%RH)
- ③ ベーキング処理後低湿保管ケースに保管 (5%RH)

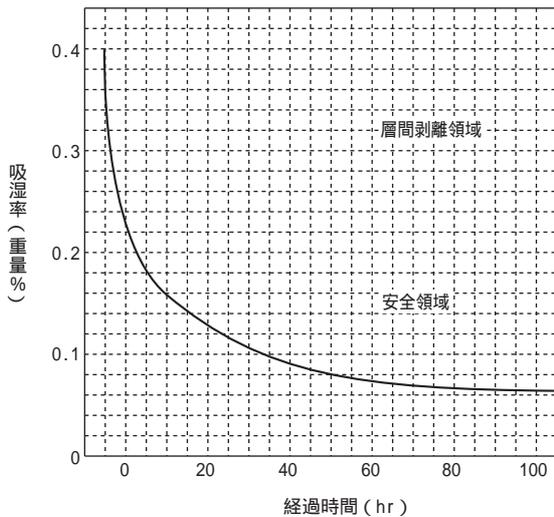
薄板多層プリント配線板の低湿保管

6-8411-01, 6-6457-01, 1-6542-01

薄板多層プリント配線板は板厚が薄くなればなる程吸湿率が大きくなります。その含水量が0.2重量%以上になると実装工程でのリフローソルダリングの熱で層間剥離、ミーズリング等の異常が発生しますので低湿保管ケースに保管して下さい。

プリント基板（ガラスエポキシ基材）

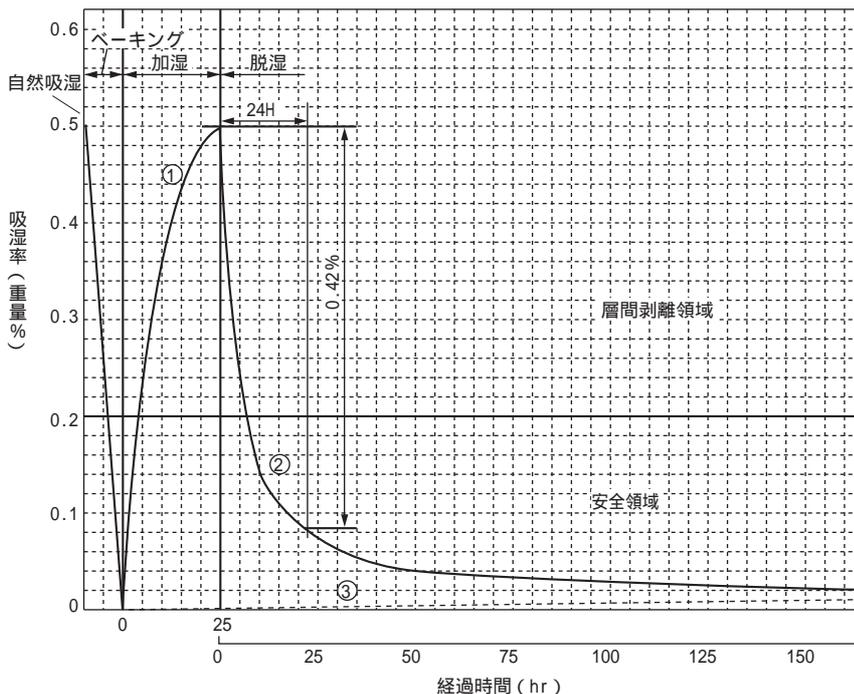
6-8411-01, 6-6457-01, 1-6542-01



試料：薄板多層プリント配線板 6層
 寸法：50×100×1t
 測定条件
 前処理：+125 で24時間ベーキング処理
 加湿：2時間煮沸
 脱湿：低湿保管ケースに保管（5%RH）

PBGAキャリア基板

6-8411-01, 6-6457-01, 6-6542-01



測定条件
 前処理：+125 で24時間ベーキング処理
 ① 周囲環境 +30、85%RH中に25時間放置（恒温恒湿室を使用）
 ② 上記①の処理後、低湿保管ケースに150時間保管（5%RH）
 ③ ベーキング処理後低湿保管ケースに保管（5%RH）